证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2026-046

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年7月4日以书面送达方式发出通知，并于2026年7月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的议案》

同意公司首次公开发行募集资金募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”予以结项，节余募集资金共计约人民币43,866.79万元（截至2026年7月2日数据，具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准），其中，将节余募集资金36,895.12万元用于投资建设“高端智能装备制造基地项目”，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求；并将其余的节余募集资金6,971.67万元转至超募资金账户。公司董事会、董事会审计委员会对上述事项发表明确的同意意见，保荐机构五矿证券有限公司对本事项出具无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022号）核准，公司于2023年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,217.03万股，每股发行价为57.66元，应募集资金总额为人民币185,493.95万元，根据有关规定扣除发行费用16,569.21万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为168,924.74万元。该募集资金已于2023年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518ZI0096号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金投资项目及募集资金使用情况

根据《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资金额	项目建设期	预计使用募集资金金额
1	游戏机核心零部件扩产项目	40,703.32	2年	40,085.95
2	电子连接器扩产项目	25,489.77	2年	25,489.77
3	5G零部件扩产项目	21,994.49	2年	21,729.90
4	研发中心建设项目	16,030.25	2年	15,912.21
5	补充流动资金项目	27,000.00	–	27,000.00
合计		131,217.83	–	130,217.83

公司募集资金总额为人民币185,493.95万元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币16,569.21万元，实际募集资金净额为人民币168,924.74万元，其中超募资金为人民币38,706.91万元。

2023年8月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2023年7月17日预先投入募投项目的自筹资金。

2024年2月5日，公司2024年第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权的议案》，以北京国融兴华资产评估有限责任公司的《资产评估报告》为基础，经双方协商一致，以深圳西可实业有限公司整体估值贰亿伍仟万元人民币，确定目标股权转让价格，成交价格一亿叁仟万元人民币。

2025年7月11日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》及《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”及“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至2026年7月7日，同意公司对“电子连接器扩产项目”募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户。2025年7月30日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》。

2025年7月31日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议及2025年8月18日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币18,029.47万元（或等值外币）投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况为：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资金额	预计使用募集资金金额	截至2026年6月30日已使用募集资金	投资进度（%）	项目达到预定可使用状态日期
1	游戏机核心零部件扩产项目	40,703.32	40,085.95	21,082.58	52.59	2026年7月
2	电子连接器扩产项目	25,489.77	25,489.77	8,434.42	已结项	2025年7月
3	5G零部件扩产项目	21,994.49	21,729.90	10,932.84	50.31	2026年7月
4	研发中心建设项目	16,030.25	15,912.21	4,704.93	29.57	2026年7月
5	补充流动资金项目	27,000.00	27,000.00	27,821.34	103.04	/
承诺投资项目小计		131,217.83	130,217.83	72,976.11	56.04	/
超募资金			38,706.91	13,000.00	33.59	/
越南智能制造生产基地建设项目			18,029.47	0.00		2027年7月
合计			/	85,976.11		/

注：“越南智能制造生产基地建设项目”在募集资金实际到位之前，部分投资款项由公司以自筹资金先行投入，募集资金到账后，公司计划使用募集资金置换自筹资金投入金额。

公司累计使用募集资金总额人民币85,976.11万元（其中超募资金13,000万元）（不含使用闲置募集资金进行现金管理），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额总计约89,646.20万元（含累计获得的利息收入扣除手续费支出净额）。（以上数据未经审计）

二、本次结项的部分募投项目资金使用情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”。截至2025年7月2日，公司募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”已基本投资建设完成，达到可使用状态并投入使用。

（一）本次结项的部分募投项目资金节余情况

单位：万元

项目名称	预计使用募集资金金额	截至2026年7月2日已使用募集资金	累计投入比例（%）	尚未使用的募集资金	净利息	募集资金节余金额
游戏机核心零部件扩产项目	40,085.95	21,082.58	52.59	19,003.37	1,321.21	20,324.58
5G零部件扩产项目	21,729.90	10,932.84	50.31	10,797.06	816.63	11,613.69
研发中心建设项目	15,912.21	4,704.93	29.57	11,207.28	721.24	11,928.52
合计	77,728.06	36,720.35	46.64	41,007.71	2,859.08	43,866.79

截至2026年7月2日，“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”预计未使用募集资金金额共计约43,866.79万元，其中，公司拟将节余募集资金人民币36,895.12万元投资建设“高端智能装备制造基地项目”，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求，并将其余的节余募集资金6,971.67万元转至超募资金账户。

本次结项的部分募投项目资金最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。若在资金转出前该项目产生新的支出，募集资金仍将继续用于该募投项目相关款项的支付；若上述资金转出后尚有募投项目尾款未支付的，公司将以自有资金支付。

（二）本次结项募集资金专户存储情况

截至2026年7月2日，“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金开户银行	资金账号	资金余额
1	游戏机核心零部件扩产项目	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	756277176301	20,324.58
2	5G零部件扩产项目	招商银行股份有限公司深圳分行	755924861810806	90.45
		宁波银行股份有限公司深圳光明支行	86031110000371368	11,523.24
3	研发中心建设项目	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	761477180334	11,928.52

注：资金余额包含正在进行现金管理的金额。

募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会提请股东会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

（三）本次结项的部分募投项目节余的主要原因

1、目前，“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”的场地建设、装修工程等基础设施建设已完成，其中“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”已经具备一定的生产能力，满足目前相关业务的生产需求。受宏观环境、行业景气度、下游客户需求变动等因素影响，募投项目的外部实施环境较立项时出现明显的变化，为适应变化，公司计划将“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”予以结项。

2、公司在募投项目实施过程中，始终秉持合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金，确保在保障项目建设质量的前提下，加强对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，优化资金配置与成本控制。

3、公司为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理并取得现金管理收益，以及募集资金存放期间产生一定利息收益。

三、使用本次节余的部分募集资金投资建设新项目的具体情况

（一）项目概述

为了提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司本次计划使用本次节余募集资金36,895.12万元投资建设高端智能装备制造基地项目。本项目通过建设装修42,600.00平方米生产车间及配套建筑物，并采购一系列先进的机器设备、检测设备及其他辅助设备用于公司精密零部件的精密组装与自动化生产等，整体提升公司精密零部件产品的产能，扩大公司生产规模。

通过本项目的实施，公司将进一步丰富产品结构，满足客户的制造与交付需求，并为进一步开发市场提供产能支持，促进公司主营业务可持续发展。本次新建项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

（二）新建募投项目基本情况和投资计划

1、项目名称：高端智能装备制造基地项目

2、项目实施主体：深圳市致尚科技股份有限公司

3、项目实施地点：深圳市光明区马田街道公明南环大道，土地用途：普通工业用地

4、项目建设内容：建设装修42,600.00平方米生产车间及配套建筑物，并购置安装相关设备

5、项目建设周期：本项目建设周期为24个月

6、项目投资金及来源：本项目计划投资总额人民币36,895.12万元，拟使用本次节余的部分募集资金36,895.12万元。

7、项目投资构成及预期经济效益具体如下：

项目总投资36,895.12万元，其中建设投资30,826.38万元，包括生产厂房建设9,372.00万元，生产厂房装修4,260.00万元，设备购置及安装费14,783.15万元，工程建设其他费用127.80万元，预备费2,283.43万元；以及铺底流动资金6,068.74万元。

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例
1	建设投资	30,826.38	83.55%
1.1	生产厂房建设	9,372.00	25.40%
1.2	生产厂房装修	4,260.00	11.55%
1.3	设备购置及安装费	14,783.15	40.07%
1.4	工程建设其他费用	127.80	0.35%
1.5	预备费	2,283.43	6.19%
2	铺底流动资金	6,068.74	16.45%
	项目总投资	36,895.12	100.00%

项目预期经济效益：项目主要产品为精密零部件等，项目完全达产后预计可实现年均销售收入103,000.00万元，投资回报率为35.76%，税后内部收益率为16.87%，税后静态投资回收期为7.51年（含建设期）。

上述项目经济效益分析数据是基于目前市场状况及成本费用水平估算的结果，不作为盈利预测，不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在估算数据与实际有较大差异的可能。

（三）新建募投项目可行性分析

1、项目建设背景

（1）数据中心建设加快，推动光通信产品市场发展

光通信行业的发展与人工智能算力需求的不断增长密切相关，是人工智能算力产业链中的重要板块。随着人工智能大模型与云计算的广泛应用，数据传输及处理需求呈现爆发式增长态势，光通信产品作为支撑算力网络的重要载体，向高密度、高集成度、高速率、低功耗等方向迭代演进。在此背景下，数据中心作为承载算力资源调配的核心基础设施，通过集成计算、存储和网络资源，支撑人工智能、云计算、大数据等技术的落地应用。数据中心建设加快推进，带动光通信产品市场需求显著增长。近年来，北美云厂商在数据中心领域的资本开支大幅增长，进一步增加对人工智能领域的投资。同时，国内的互联网厂商也纷纷推进算力建设。根据咨询机构IDC发布的《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》预测数据，2025年中国智能算力规模将达到1,037.3EFLOPS，并在2028年达到2,781.9EFLOPS，2025-2028年中国智能算力规模的年复合增长率达38.94%。2024年中国人工智能算力市场规模约为190亿美元，2025年将达到259亿美元，同比增长36.32%，2028年将达到552亿美元，呈现快速增长的趋势。

（2）居民人均可支配收入的提高增强人们文化娱乐消费的支付能力

近年来，人民的生活水平稳步提高，消费结构随之发生了显著变化，消费者对于娱乐产品的需求愈发多元化，游戏成为一种重要的娱乐方式，是大众休闲生活的重要组成部分。同时，游戏玩家不再满足于普通的游戏配置，对游戏体验的追求不断提升，高品质的游戏主机、高性能的游戏配件极大地改善玩家的游戏体验。消费者对游戏体验的高要求推动了游戏机零部件市场需求的持续增长。根据New zoo发布的《2025全球游戏市场报告》，全球游戏总收入预计将达到1,888亿美元（同比增长3.4%），其中移动游戏继续占据主导地位（占55%，1,030亿美元），主机游戏占24%（459亿美元），PC游戏占21%（399亿美元）。未来三年（2025-2028），整体复合增长率预计为2.9%；同时，年轻消费者对新鲜事物的接受能力和消费意愿较强，现有游戏用户叠加新一代年轻消费者，游戏市场将持续增长，2025年全球游戏玩家总数已达36亿人，同比增长4.4%。

（3）国家产业政策支持促进行业发展

2025年8月，国务院颁布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。2025年5月，工信部、发改委、国家数据局颁布的《电子信息制造业数字化转型实施方案》，加强新型信息基础设施建设。统筹推进先进计算产业发展，加快网络、算据、算力、算法等融合贯通，推动高性能计算、智能计算、云边端协同计算等创新发展，完善边缘计算中心网络布局，建设高可靠、高性能、广连接的新型信息基础设施。推动新型信息基础设施深度赋能电子信息制造业应用，加快先进计算、5G-A、千兆光网、工业互联网、人工智能在电子信息制造业中的规模化应用。

2、项目实施的必要性

（1）把握行业发展机遇，扩大公司主要产品产能

近年来，公司主营业务所处行业呈现出蓬勃发展的态势。公司目前处于快速成长期，但受限于现有的生产规模，已面临部段性产能饱和的问题，下游客户快速增长的订单需求无法得到全面满足。本次募投项目拟建设装修42,600.00平方米生产车间及配套建筑物，并购置安装相关设备，用于扩大公司主营产品相关的精密零部件产能及生产规模。

通过本项目的实施，公司能够新增生产线，进一步提升公司精密零部件产品的产能，突破当前的产能瓶颈，提高公司主营产品的供应能力与服务能力，增强公司订单承接及交付能力，进而进一步巩固公司在相关市场的竞争地位，实现公司的可持续发展。

（2）顺应行业发展趋势，提升公司高端精密零部件的制造能力

随着公司主营业务下游应用场景持续拓展演进，公司客户对精密零部件的尺寸公差、表面精度、一致性及稳定性等核心技术指标提出更高的标准。因此，公司精密零部件产品需要向高精度、小型化、集成化方向迭代升级，若公司的产品品质无法及时匹配下游客户产品的更新迭代需求，不仅会错失市场机会，更有可能面临被同行业竞争者替代的风险。

为匹配行业技术升级趋势并承接客户高端订单的需求，通过本次募投项目的实施，公司拟购置一系列先进的精密加工、检测及智能化生产设备，夯实公司精密制造的基础，并配合公司成熟的工艺研发与生产管理优势，全面提升公司精密零部件产品的制造能力，快速响应核心客户高端产品订单，提高客户满意度。

（3）进一步丰富公司产品结构，满足公司业务持续发展的需要

公司以精密制造为核心，专注于小型化、高密度的精密零部件（如光纤连接器、游戏机零部件等）的模具开发、注塑成型、精密组装与自动化生产，满足光通信与消费电子领域对微型结构件的高强度、高可靠性及批量一致性要求。公司下游行业的产品种类多样，精密零部件的功能与种类出现更加多样化的趋势。通过本次募投项目的实施，公司将扩宽公司的产品布局，增加高附加值精密零部件产品品类，提高客户满意度，强化公司与客户战略粘性，满足公司业务持续发展的需要。

3、项目实施的可行性

（1）优质的客户资源

境内外知名客户对供应链准入门槛较高，对供应商管理体系要求比较严格，要求供应商具备较强的产品研发能力、较好的生产和检测水平以及良好的售后跟踪服务，对供应商资质及产品的审核严格。公司凭借稳定可靠的质量控制体系、持续的技术创新能力、精细化成本管理、高效交付能力与完善的售后服务体系，通过客户长期、严格的资质审核、产品验证与现场认证，已成为多家境内外知名企业的合格供应商，建立起长期稳定的合作关系，为本项目的实施提供坚实的市场基础。

（2）公司丰富的研发生产经验

自创立以来，公司秉承自主创新、自主研发的经营理念，围绕核心客户需求持续进行研发投入，不断丰富产品种类及提高技术含量，建立具有独立知识产权的核心技术体系。公司不断提升产品开发设计能力，持续丰富产品种类及提高技术含量。公司将充分发挥在精密制造领域的技术能力，在产品设计环节能快速适配客户的定制化需求，并快速投入批量化生产，在质量管控环节建立覆盖全生产流程的标准化质检体系。

因此，公司在产品研发、设计、生产等方面的经验积累和沉淀，保障公司产品和技术的先进性，为本项目的顺利实施提供有利条件。

（3）公司具备丰富的行业经验

公司具有多年的行业经验积累和沉淀，能够全面渗入客户产品的研发、设计、生产等过程中。这不仅能够为客户提供优质的产品和服务，还能够使公司充分了解市场和技术的发展趋势，加快对具有前瞻性的产品或技术进行开发，从而保障公司产品和技术的先进性，提高公司综合竞争力，为本项目的顺利实施提供有利条件。

4、项目实施面临的风险及应对措施

（1）产品研发与技术迭代风险及控制措施

本项目涉及的主要产品为精密零部件等产品，应用覆盖各类通信电子、消费电子、工业自动化等领域，相关行业技术升级迭代速度较快。如果公司对产品和市场的发展趋势判断失误，技术研发及产品创新不能满足下游行业快速发展的需要，技术路线和产品定位未能根据市场变化及时进行调整，新技术、新产品不能得到客户认可，公司产品将存在被替代的风险。

针对该风险，公司坚持研发创新，密切关注市场的发展趋势和产品的技术变化，完善公司的研发体系，加大研发投入，及时调整研发方向和技术储备。

（2）全球宏观经济波动风险

当前，全球地缘政治不确定性较高，复杂多变的宏观环境将影响终端市场的消费能力以及产业链上下游投资发展意愿。近年来，公司积极拓展国际业务，面对全球宏观经济波动以及国际政治的不确定性，如果公司不能灵活调整应对宏观环境变动风险，将可能对本次募投项目的实施产生负面影响。

针对该风险，公司将密切关注国内外宏观经济形势的变化，做好行业分析和战略研究，以创新为驱动力，不断提升产品核心竞争力，积极发展新品类领域业务，培育新的增长点，努力降低运营风险。

（3）募投项目产能未能有效消化的风险

本次募投项目达产前量是根据公司客户的采购预测需求量和下游市场发展前景测算，具有一定合理性。公司具备与本次募投项目相关的技术、人员及运营管理经验，且部分产品已实现销售。但如果未来客户需求或行业发展不及预期，且公司未能有效开拓其他客户，本次募投项目将存在产能过剩，从而造成公司未来出现产品价格下降、毛利率下滑的风险。

针对该风险，公司将实时关注市场、产业及技术等发展趋势，为项目的顺利开展做好多方面准备。同时，公司将进一步完善业务结构，不断开拓市场，增强公司持续盈利能力。

（四）新增开立的募集资金专项账户的情况

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金。同时，为确保募集资金规范管理和使用，保障募投项目实施效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层及财务部门办理与本次募集资金专项账户相关的事项，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金三方监管协议等。

四、本次节余的部分募集资金转至超募资金账户的具体情况

为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将扣除高端智能装备制造基地项目预计使用的36,895.12万元后的其余节余募集资金6,971.67万元转至公司超募资金专户储存（截至2026年7月2日数据，具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准）。募集资金投资项目结项并转至超募资金账户后，后续如需支付尚未达到付款状态的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。

公司将根据行业发展状况和趋势、自身发展规划以及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排使用计划。

五、本次部分募投项目结项并将部分节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户对公司的影响

（一）本次部分募投项目结项并将部分节余募集资金投资建设新项目对公司的影响

公司本次使用部分募投项目节余资金投资建设新项目是基于公司对主营业务相关的精密零部件近期市场变化及客户对产品需求做出的谨慎、合理决策，有利于扩大公司主要产品产能，提升公司高端精密零部件的制造能力，进一步丰富公司产品结构，提升公司竞争力和盈利能力，符合公司主营业务的发展方向和发展战略。

本次使用部分募投项目节余资金投资建设新项目有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在影响公司及全体股东利益的情形。公司将积极加强对本项目建设内容和进度的监督管理，从而提高募集资金的使用效益。

（二）本次部分募投项目结项并将部分节余募集资金转至超募资金账户对公司的影响

公司严格遵守募集资金管理的有关规定，并在保证募投项目质量的前提下，合理节约了部分募集资金。公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

经审议，董事会审计委员会认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户事项是基于公司业务开展的实际需要，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

（二）董事会审议情况

经审议，公司董事会同意将公司首次公开发行募集资金募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”予以结项，拟将节余募集资金人民币36,895.12万元投资建设“高端智能装备制造基地项目”，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求，并将节余募集资金6,971.67万元转至超募资金账户。募集资金转出后，公司将办理相关募投项目募集资金账户销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会提请股东会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项，同时，办理与本次新项目募集资金专项账户相关的事项，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件，签订募集资金三方监管协议等。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户事项已经公司董事审议通过，相关事项履行必要的审批程序，尚需提交股东会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户相关事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的核查意见》

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026年7月8日

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2026-047

深圳市致尚科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的议案》，拟将公司首次公开发行募集资金募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”予以结项，节余募集资金共计约4,866.79万元（截至2026年7月2日数据，具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准），其中，将节余募集资金36,895.12万元用于投资建设“高端智能装备制造基地项目”，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求；并将其余的节余募集资金6,971.67万元转至超募资金账户。公司董事会、董事会审计委员会对上述事项发表明确的同意意见，保荐机构五矿证券有限公司对本事项出具无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022号）核准，公司于2023年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,217.03万股，每股发行价为57.66元，应募集资金总额为人民币185,493.95万元，根据有关规定扣除发行费用16,569.21万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为168,924.74万元。该募集资金已于2023年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518ZI0096号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金投资项目及募集资金使用情况

根据《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资金额	项目建设期	预计使用募集资金金额
1	游戏机核心零部件扩产项目	40,703.32	2年	40,085.95
2	电子连接器扩产项目	25,489.77	2年	25,489.77
3	5G零部件扩产项目	21,994.49	2年	21,729.90
4	研发中心建设项目	16,030.25	2年	15,912.21
5	补充流动资金项目	27,000.00	–	27,000.00
合计		131,217.83	–	130,217.83

公司募集资金总额为人民币185,493.95万元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币16,569.21万元，实际募集资金净额为人民币168,924.74万元，其中超募资金为人民币38,706.91万元。

2023年8月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2023年7月17日预先投入募投项目的自筹资金。

2024年2月5日，公司2024年第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权的议案》，以北京国融兴华资产评估有限责任公司的《资产评估报告》为基础，经双方协商一致，以深圳西可实业有限公司整体估值贰亿伍仟万元人民币，确定目标股权转让价格，成交价格一亿叁仟万元人民币。

2025年7月11日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》及《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”及“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至2026年7月7日，同意公司对“电子连接器扩产项目”募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户。2025年7月30日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》。

2025年7月31日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议及2025年8月18日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币18,029.47万元（或等值外币）投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况为：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资金额	预计使用募集资金金额	截至2026年6月30日已使用募集资金	投资进度（%）	项目达到预定可使用状态日期
1	游戏机核心零部件扩产项目	40,703.32	40,085.95	21,082.58	52.59	2026年7月
2	电子连接器扩产项目	25,489.77	25,489.77	8,434.42	已结项	2025年7月
3	5G零部件扩产项目	21,994.49	21,729.90	10,932.84	50.31	2026年7月
4	研发中心建设项目	16,030.25	15,912.21	4,704.93	29.57	2026年7月
5	补充流动资金项目	27,000.00	27,000.00	27,821.34	103.04	/
承诺投资项目小计		131,217.83	130,217.83	72,976.11	56.04	/
超募资金			38,706.91	13,000.00	33.59	/
越南智能制造生产基地建设项目			18,029.47	0.00		2027年7月
合计			/	85,976.11		/

注：“越南智能制造生产基地建设项目”在募集资金实际到位之前，部分投资款项由公司以自筹资金先行投入，募集资金到账后，公司计划使用募集资金置换自筹资金投入金额。

公司累计使用募集资金总额人民币85,976.11万元（其中超募资金13,000万元）（不含使用闲置募集资金进行现金管理），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额总计约89,646.20万元（含累计获得的利息收入扣除手续费支出净额）。（以上数据未经审计）

二、本次结项的部分募投项目资金使用情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”。截至2025年7月2日，公司募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”已基本投资建设完成，达到可使用状态并投入使用。

（一）本次结项的部分募投项目资金节余情况

单位：万元

项目名称	预计使用募集资金金额	截至2026年7月2日已使用募集资金	累计投入比例（%）	尚未使用的募集资金	净利息	募集资金节余金额
游戏机核心零部件扩产项目	40,085.95	21,082.58	52.59	19,003.37	1,321.21	20,324.58
5G零部件扩产项目	21,729.90	10,932.84	50.31	10,797.06	816.63	11,613.69
研发中心建设项目	15,912.21	4,704.93	29.57	11,207.28	721.24	11,928.52
合计	77,728.06	36,720.35	46.64	41,007.71	2,859.08	43,866.79

截至2026年7月2日，“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”预计未使用募集资金金额共计约43,866.79万元，其中，公司拟将节余募集资金人民币36,895.12万元投资建设“高端智能装备制造基地项目”，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求，并将其余的节余募集资金6,971.67万元转至超募资金账户。

本次结项的部分募投项目资金最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。若在资金转出前该项目产生新的支出，募集资金仍将继续用于该募投项目相关款项的支付；若上述资金转出后尚有募投项目尾款未支付的，公司将以自有资金支付。

（二）本次结项募集资金专户存储情况

截至2026年7月2日，“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金开户银行	资金账号	资金余额
1	游戏机核心零部件扩产项目	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	756277176301	20,324.58
2	5G零部件扩产项目	招商银行股份有限公司深圳分行	755924861810806	90.45
		宁波银行股份有限公司深圳光明支行	86031110000371368	11,523.24
3	研发中心建设项目	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	761477180334	11,928.52

注：资金余额包含正在进行现金管理的金额。

募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会提请股东会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

（三）本次结项的部分募投项目节余的主要原因

1、目前，“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”的场地建设、装修工程等基础设施建设已完成，其中“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”已经具备一定的生产能力，